

Bernd Deutschmann
Technische Universität Graz
Institut für Elektronik (4390)



Anstellung

Technische Universität Graz
Institut für Elektronik (4390)
Technische Universität Graz (90000)
Graz, Österreich
1 März 2014 → present

Veröffentlichungen

EMI Robust Comparator Design for Protection Features of Smart Power Switches

Kircher, D., Ionascu, C. & Deutschmann, B., 9 Okt. 2024, *2024 14th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo)*. IEEE CSP, S. 92-95 4 S. 10742034

Evaluation of the Electromagnetic Emission of ICs Using Different Spread Spectrum Approaches

Pfeifer, M., Odreitz, K. & Deutschmann, B., 9 Okt. 2024, *2024 14th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo)*. IEEE CSP, S. 106-110 5 S. 10742044

Characterisation of an EMI-Improved Integrated Folded Cascode Amplifier Structure Using the EMIRR Measurement Method

Zupan, D., Czepl, N. & Deutschmann, B., Okt. 2024, *2024 14th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo)*. IEEE, 4 S.

Effects of Ionizing Radiation on the EMI-Induced Offset Voltage of Operational Amplifiers

Czepl, N., Zupan, D., Michalowska-Forsyth, A. M. & Deutschmann, B., Okt. 2024, *2024 14th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo)*. IEEE, 4 S.

Ionising Radiation Induced Changes in the Electromagnetic Emission of Integrated Circuits

Czepl, N., Ramazanoglu, S., Michalowska-Forsyth, A. & Deutschmann, B., 2 Sept. 2024, *2024 International Symposium on Electromagnetic Compatibility – EMC Europe*. 2024 Aufl. IEEE Publications, S. 872-876 5 S. (Proceedings of the International Symposium on Electromagnetic Compatibility, EMC Europe).

Resonance Mode Analysis on Conducted Emissions of an Inverting Buck–Boost Converter

Odreitz, K., Musil, M. & Deutschmann, B., 2 Sept. 2024, *2024 International Symposium on Electromagnetic Compatibility – EMC Europe*. S. 973 - 978

Performance evaluation of the FastIC readout ASIC with emphasis on Cherenkov emission in TOF-PET

Piller, M., Castilla, A. M., Terragni, G., Alozy, J., Auffray, E., Ballabriga, R., Campbell, M., Deutschmann, B., Gascon, D., Gola, A., Merzi, S., Michalowska-Forsyth, A., Penna, M., Gómez, S. & Kratochwil, N., 7 Juni 2024, in: *Physics in Medicine and Biology*. 69, 11, 115014.

A modular and scalable system for electromagnetic compatibility testing of integrated circuits

Kircher, D., Profanter, S. & Deutschmann, B., März 2024, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik*. 141, 1, S. 47-55 9 S.

Bias dependence in statistical random telegraph noise analysis based on nanoscale CMOS ring oscillators

Ramazanoglu, S., Michalowska-Forsyth, A. & Deutschmann, B., März 2024, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik*. 141, 1, S. 37-46 10 S.

Electromagnetic emission of integrated circuits induced by ionizing radiation and its measurement uncertainties

Czepl, N., Juch, N. & Deutschmann, B., März 2024, in: Elektrotechnik und Informationstechnik. 141, 1, S. 56-65 10 S.

Influence of the IC power supply and decoupling capacitor arrangement on the electromagnetic emission

Deutschmann, B. & Juch, N., März 2024, in: Elektrotechnik und Informationstechnik. 141, 1, S. 66-75 10 S.

A Novel Method for Testing the Electromagnetic Immunity of the Short Circuit Protection Function of Smart Power Switches

Kircher, D., Deutschmann, B. & Helldorff, H., 2024, *2024 IEEE Joint International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Signal and Power Integrity: EMC Japan/Asia Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility, EMC Japan/APEMC Okinawa 2024 - Proceedings*. IEEE, S. 661-664 4 S.

Effects of Ionising Radiation on the Electromagnetic Immunity Behaviour of Integrated Circuits

Czepl, N., Kircher, D. & Deutschmann, B., 2024, *2024 IEEE Joint International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Signal and Power Integrity: EMC Japan/Asia Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility, EMC Japan/APEMC Okinawa 2024 - Proceedings*. IEEE, S. 609-612 4 S.

Electromagnetic Immunity of the Overtemperature Protection of Smart Power High Side Switches

Kircher, D., Ionascu, C. & Deutschmann, B., 2024, *Proceedings of the International Symposium on Electromagnetic Compatibility, EMC Europe*. Band 2024. S. 861-866 6 S. (Proceedings of the International Symposium on Electromagnetic Compatibility, EMC Europe).

Morris Sensitivity Analysis on Conducted Emissions of an Inverting Buck-Boost Converter

Odreitz, K., Musil, M. & Deutschmann, B., 2024, *2024 IEEE Joint International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Signal and Power Integrity: EMC Japan/Asia Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility, EMC Japan/APEMC Okinawa 2024 - Proceedings*. IEEE, S. 665-668 4 S.

Fast28 a low-power fast readout design for SiPMs in 28nm CMOS

Piller, M., Ballabriga, R., Bandi, F. N., Campbell, M., Deutschmann, B., Fernández-Tenllado, J. M., Gascon, D., Gomez, S., Michalowska-Forsyth, A. M. & Mauricio, J., Nov. 2023, *Proceedings of 2023 IEEE Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference and International Symposium on Room-Temperature Semiconductor Detectors (NSS MIC RTSD)*. IEEE Xplore

ICEM-CE Modeling at SPICE-Level

Odreitz, K., Minichmair, F., Maier, C., Juch, N. & Deutschmann, B., 27 Sept. 2023.

A Modular Approach of an Electromagnetic Compatibility Test System for Integrated Circuits

Kircher, D., Deutschmann, B. & Profanter, S., 21 Sept. 2023, *2023 Austrochip Workshop on Microelectronics, Austrochip 2023 - Proceedings*. ACM/IEEE, S. 19-22 4 S. 10285156

Evaluation of Using Kelvin Contacts for Integrated Circuit Decoupling Capacitors

Juch, N. & Deutschmann, B., Sept. 2023.

Importance of Power Supply Pinning for Electromagnetic Emission Reduction in Modern IC Packaging

Deutschmann, B. & Juch, N., Sept. 2023.

Framework to Simulate and Analyse the Electromagnetic Emission of Integrated Circuits under Electromagnetic Interference

Zupan, D., Kircher, D., Czepl, N. & Deutschmann, B., 5 Juli 2023, *2023 19th International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design (SMACD)*. ACM/IEEE, 4 S. 10192236

A Sub-100 mV AC/DC Converter with Impedance Matching for Magnetic Field Energy Harvesting

Dillersberger, H., Tham, D. & Deutschmann, B., 18 Juni 2023, *PRIME 2023 - 18th International Conference on Ph.D Research in Microelectronics and Electronics, Proceedings*. IEEE, S. 357-360 4 S.

Procedure for the Selection of Decoupling Capacitors

Deutschmann, B., Juch, N. & Winkler, G., 25 Mai 2023, *2023 Joint Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility and International Conference on ElectroMagnetic Interference and Compatibility, APEMC/INCEMIC 2023*. ACM/IEEE, 4 S. 10217536. (2023 Joint Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility and International Conference on ElectroMagnetic Interference and Compatibility, APEMC/INCEMIC 2023).

Effiziente Modellierung der Elektromagnetischen Interferenz einer Gallium-Nitrid-Halbbrücke

Hansen, J. & Deutschmann, B., Feb. 2023, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik*. 140, 1, S. 95-102 8 S.

A Method to Measure the Electromagnetic Emission Induced by Electromagnetic Interference of Integrated Circuits

Kircher, D., Czepl, N., Zupan, D. & Deutschmann, B., 2023, (Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung.) *2023 Joint Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility and International Conference on ElectroMagnetic Interference and Compatibility, APEMC/INCEMIC 2023*. IEEE, 4 S.

Characterizing the Electromagnetic Immunity of Operational Amplifiers based on EMIRR and DPI

Deutschmann, B. & Winkler, G., 2023, *2023 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC Europe, EMC Europe 2023*. IEEE, 4 S.

Impact of Dual-Tone Interference on an Automotive Smart Power High-Side Switch using Direct Power Injection

Kircher, D., Rosenmayr, F. & Deutschmann, B., 2023, (Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung.) *2023 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC Europe, EMC Europe 2023*. IEEE, 5 S.

Impact of Power Supply Arrangement on Electromagnetic Emission from ICs

Deutschmann, B. & Juch, N., 2023, *2023 Austrochip Workshop on Microelectronics, Austrochip 2023 - Proceedings*. S. 31-34

Impact of Supply Voltage and Operating Point in IC PDN Modeling

Odreitz, K., Maier, C., Minichmair, F. & Deutschmann, B., 2023, *2023 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC Europe, EMC Europe 2023*. IEEE, (IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility; Band 2023-September).

Interference-induced Electromagnetic Emission in Functioning Operating States of Integrated Circuits

Czepl, N., Kircher, D. & Deutschmann, B., 2023, (Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung.) *2023 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC Europe, EMC Europe 2023*. IEEE, 4 S.

Investigating the Use of Frequency-Modulated Disturbance Injection in Electromagnetic Immunity Testing of Integrated Circuits

Kircher, D., Rosenmayr, F. & Deutschmann, B., 2023, (Elektronische Veröffentlichung vor Drucklegung.) *2023 Joint Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility and International Conference on ElectroMagnetic Interference and Compatibility, APEMC/INCEMIC 2023*. IEEE, 4 S.

Nanoscale CMOS Ring Oscillators for Statistical Characterization of Random Telegraph Noise

Ramazanoglu, S., Michalowska-Forsyth, A. & Deutschmann, B., 2023, *2023 Austrochip Workshop on Microelectronics, Austrochip 2023 - Proceedings*. IEEE, S. 27-30 4 S.

Electromagnetic Emission of ICs Measured with a TEM Cell

Deutschmann, B. & Juch, N., 21 Sept. 2022, S. 7-7.

Investigation of the Connection of Decoupling Capacitors with Regard to Electromagnetic Emission

Deutschmann, B. & Juch, N., 21 Sept. 2022, S. 6-6.

Reduction of conducted emission through optimum placement and selection of decoupling capacitors

Deutschmann, B., Juch, N. & Winkler, G., 21 Sept. 2022, *19. EMV-Fachtagung 2022*. Winkler, G. (Hrsg.). OVE, S. 53-62 (OVE Schriftenreihe ; Band 107).

SSCS Austria Chapter Welcomes Distinguished Lecturer Prof. Bernhard Wicht

Hueber, G. & Deutschmann, B., 10 Juli 2022, IEEE Solid-State Circuits Magazine, 14, 2, S. 86.

Der Fachkräftemangel in der Electronics Based Systems-Industrie: Gastkommentar

Deutschmann, B., Mai 2022, Elektrotechnik und Informationstechnik, 139, 3, S. 11-11.

A Fault Tree Approach Focusing on Electromagnetic Interference

Hörmaier, K., Zangl, H., Kircher, D. & Deutschmann, B., 11 März 2022, *2021 13th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits, EMC Compo 2021*. IEEE, S. 133-138 6 S.

Influence of Layout Parasitics on EMI Improved Folded Cascode Amplifier Input Stages Using Compensation Methods

Zupan, D., Czepl, N. & Deutschmann, B., 9 März 2022, *2021 13th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo)*. IEEE, S. 9-12 4 S.

Reduction of Electromagnetic Emission from ICs Using Soft Flexible Ferrite Sheets

Deutschmann, B., Khan, J. S., Winkler, G. & Victoria, J., 9 März 2022.

Functional Safety Risks of Smart Power Devices due to EMI

Deutschmann, B. & Kircher, D., 2022, *Proceedings EMV Kongress 2022*. Aachen: Apprimus Verlag, S. 201-207 7 S.

Generic Analog 8 Bit DAC IP Block in 28nm CMOS for the High Energy Physics Community

Piller, M., Ballabriga, R., Bandi, F. N., Borghello, G., Ceresa, D., Pejasinovic, R., Sriskaran, V., Michalowska-Forsyth, A. & Deutschmann, B., 2022, *Austrochip 2022 - 30th Austrochip Workshop on Microelectronics*. IEEE, S. 5-8 4 S.

Influence of Radio Frequency Interference on the Electromagnetic Emission of Integrated Circuits

Kircher, D., Deutschmann, B. & Czepl, N., 2022, *2022 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC Europe, EMC Europe 2022*. IEEE, S. 257-261 5 S.

Hot electron effects in AlGaIn/GaN HEMTs during hard-switching events

Minetto, A., Modolo, N., Meneghini, M., Zanoni, E., Sayadi, L., Sicre, S., Deutschmann, B. & Häberlen, O., Nov. 2021, in: *Microelectronics Reliability*. 126, 114208.

Impact of place and route strategy on FPGA electromagnetic emission

Lara, E. L., Constante, A. A., Benfica, J., Vargas, F., Boyer, A., Dhia, S. B., Gleinser, A., Winkler, G. & Deutschmann, B., Nov. 2021, in: *Microelectronics Reliability*. 126, 114333.

Influence of ionizing radiation on the conducted electromagnetic emission of integrated circuits

Czepl, N., Deutschmann, B. & Michalowska-Forsyth, A., Nov. 2021, in: *Microelectronics Reliability*. 126, 114335.

Drain Field Plate Impact on the Hard-Switching Performance of AlGaIn/GaN HEMTs

Minetto, A., Modolo, N., Sayadi, L., Koller, C., Ostermaier, C., Meneghini, M., Zanoni, E., Prechtel, G., Sicre, S., Deutschmann, B. & Häberlen, O., Okt. 2021, in: *IEEE Transactions on Electron Devices*. 68, 10, S. 5003 - 5008 6 S.

Square Wave Shaper with Filter Characteristics to Reduce EMI and Passive Component Count

Nadgouda, R., Hackl, H. & Deutschmann, B., 26 Juli 2021, *2021 Joint IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility Signal and Power Integrity, and EMC Europe, EMC/SP/PI/EMC Europe 2021*. IEEE, S. 783-786 4 S.

Preliminary Study on the Impact of Place and Route Strategy on FPGA Electromagnetic Emission

Lara, E. L., Constante, A. A., Benfica, J., Vargas, F., Boyer, A., Dhia, S. B., Gleinser, A., Winkler, G. & Deutschmann, B., 11 März 2021, *2021 Argentine Conference on Electronics - Congreso Argentino de Electronica 2021, CAE 2021*. IEEE, S. 88-92 5 S. 9397567

Fast and simple model generation for superjunction power MOSFETs: An easy way to get accurate SPICE models even without exact information from the datasheet

Fuchs, M., Spielberger, L., Odreitz, K. & Deutschmann, B., Feb. 2021, in: Elektrotechnik und Informationstechnik. 138, 1, S. 48-52 5 S.

Leistungselektronik/Leistungshalbleiter – Anwendungen von Milliwatt bis Megawatt, vom Mikrochip bis zum System

Deutschmann, B., Feb. 2021, in: Elektrotechnik und Informationstechnik. 138, 1

Influence of Layout Parasitics on EMI Improved Folded Cascode Amplifier Input Stages Using Filtering and Linearisation Methods

Zupan, D., Czepl, N. & Deutschmann, B., 2021, *Proceedings of the 2021 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility, APEMC 2021*. IEEE, S. 1-4

Reduction of Electromagnetic Emission from ICs Using Soft Flexible Ferrite Sheets

Deutschmann, B., Khan, J. S., Winkler, G. & Victoria, J., 2021, *2021 13th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits, EMC Compo 2021*. IEEE, S. 19-24 6 S.

Hot-Electron Effects in AlGaIn/GaN HEMTs under Semi-ON DC Stress

Minetto, A., Deutschmann, B., Modolo, N., Nardo, A., Meneghini, M., Zanoni, E., Sayadi, L., Prechtel, G., Sicre, S. & Haberlen, O., Nov. 2020, in: IEEE Transactions on Electron Devices. 67, 11, S. 4602-4605 4 S., 9214895.

Monitoring of parameter stability of SiC MOSFETs in real application tests

Sievers, M., Findenig, B., Glavanovics, M., Aichinger, T. & Deutschmann, B., Nov. 2020, in: Microelectronics Reliability. 114, 6 S., 113731.

System-level evaluation of dynamic effects in a GaN-based class-E power amplifier

Minetto, A., Deutschmann, B., Häberlen, O. & Curatola, G., Nov. 2020, in: Integration: the VLSI Journal . 75, S. 11-18 8 S.

A bipolar ± 13 mV self-starting and 85% peak efficiency DC/DC converter for thermoelectric energy harvesting

Dillersberger, H., Deutschmann, B. & Tham, D., 20 Okt. 2020, in: Energies. 13, 20, 11 S., 5501.

Comparison of EMI Improved Differential Input Pair Structures within an Integrated Folded Cascode Operational Transconductance Amplifier

Zupan, D. & Deutschmann, B., 7 Okt. 2020, *Proceedings - 2020 Austrochip Workshop on Microelectronics, Austrochip 2020*. IEEE, S. 47-52 6 S. 9232994

Investigation of High Frequency EMI Propagation in Current Mirror Structures using a Post-Processing Framework

Zupan, D. & Deutschmann, B., 1 Okt. 2020.

EMI-optimized driver for high-frequency boost converter

Subotskaya, V., Bodano, E. & Deutschmann, B., 1 Apr. 2020, in: Elektrotechnik und Informationstechnik. 137, 2, S. 100-106 7 S.

Herausforderungen bei der Durchführung von reproduzierbaren BCI-Messungen

Deutschmann, B. & Winkler, G., 17 März 2020, *EMV 2020 - Internationale Fachmesse und Kongress für Elektromagnetische Verträglichkeit*. Garbe, H. (Hrsg.). Mesago Messe Frankfurt GmbH, S. 213-220 8 S.

Comparison of EMI effects on different current mirror structures using a post-processing framework

Zupan, D. & Deutschmann, B., 10 März 2020, in: Elektrotechnik und Informationstechnik. 137, 2, S. 93–99 7 S.

Voltage Dependence and Characterization of Ceramic Capacitors Under Electrical Stress

Fuchs, M., Sievers, M. & Deutschmann, B., März 2020, *APEC 2020 - 35th Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition*. IEEE, S. 2815-2821 7 S. 9124365

Electromagnetic Compatibility of Electronics Based Systems Affects Us All

Deutschmann, B., Jan. 2020, in: TU Graz Research. 2020, 23, S. 24-26

Comparison of Harmonic Suppression Techniques

Nadgouda, R. & Deutschmann, B., 1 Okt. 2019, *EMC COMPO 2019 - 2019 12th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits*. IEEE, S. 272-274 3 S. 8919834

Comparison of BBSPICE to PEEC Equivalent Circuit Models for Simulation of Floating PCB above Ground Plane

Hackl, H., Ibel, M., Auinger, B., Stockreiter, C. & Deutschmann, B., 1 Sept. 2019, *2019 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE*. IEEE, S. 19-24 6 S. 8872031. (EMC Europe 2019 - 2019 International Symposium on Electromagnetic Compatibility).

Optimal current slew rate control for a three-phase MOSFET inverter driving a PMSM

Büchl, D., Kemmetmüller, W., Glück, T., Deutschmann, B. & Kugi, A., 1 Sept. 2019, in: *IFAC-PapersOnLine*. 52, 15, S. 85-90 6 S.

A new method for measuring parasitics of super junction power MOSFETs

Fuchs, M., Spielberger, L., Sygulla, C. & Deutschmann, B., Sept. 2019, *2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2019 ECCE Europe*. IEEE, 8915539

Advanced Scopes And Probes Help Optimize SMPS Gate Drives For EMC

Fuchs, M., Auinger, B., Pichler, L., Herdin, M. & Deutschmann, B., 1 Aug. 2019, *How2Power: Answering Questions About Power Design*. 8 S.

Band Specific Suppression of Harmonics and its Effects on Power Efficiency

Nadgouda, R. & Deutschmann, B., 1 Juli 2019, *PRIME 2019 - 15th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics, Proceedings*. IEEE, S. 169-172 4 S. 8787844

Identification of EMI Induced Changes during the Design of ICs using a Post-Processing Framework

Zupan, D. & Deutschmann, B., 1 Juli 2019, *SMACD 2019 - 16th International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design, Proceedings*. IEEE, S. 201-204 4 S. 8795218

A dynamic model of power metal-oxide-semiconductor field-effect transistor half-bridges for the fast simulation of switching induced electromagnetic emissions

Büchl, D., Kemmetmüller, W., Glück, T., Deutschmann, B. & Kugi, A., 4 Mai 2019, in: *Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems*. 25, 3, S. 242-260 19 S.

Survey on the generation of equivalent circuit cable models for transient simulation

Ibel, M., Hackl, H., Auinger, B., Stockreiter, C. & Deutschmann, B., 1 Mai 2019, *2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019 - Proceedings*. Skala, K., Car, Z., Pale, P., Huljenic, D., Janjic, M., Koricic, M., Sruk, V., Ribaric, S., Grbac, T. G., Butkovic, Z., Cicin-Sain, M., Skvorc, D., Mauher, M., Babic, S., Gros, S., Vrdoljak, B. & Tijan, E. (Hrsg.). IEEE, S. 102-107 6 S. 8757048. (2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2019 - Proceedings).

Investigation of SPICE Models for Overvoltage Protection Devices With Respect to Fast Transients

Bauer, S. M., Renhart, W., Biro, O., Tuerk, C., Maier, C., Winkler, G. & Deutschmann, B., 22 Apr. 2019, in: *IEEE Letters on Electromagnetic Compatibility Practice and Applications*. 1, 1, S. 20-25

Gate Driver Optimization to Reduce Conducted Emissions

Dobersberger, S., Sekerija, Z., Büchl, D., Winkler, G. & Deutschmann, B., 27 Feb. 2019. 1 S.

Optimizing Filter Circuits for DC/DC Converters to Reduce Conducted Emissions

Sekerija, Z., Dobersberger, S., Winkler, G. & Deutschmann, B., 27 Feb. 2019. 1 S.

Post-Processing Framework for Identification of EMI Induced Changes

Zupan, D. & Deutschmann, B., 27 Feb. 2019.

Semi-Automatic Generation of Lumped Element Transmission Line Circuits from 2D Cross Section

Ibel, M. G., Hackl, H., Auinger, B., Stockreiter, C. & Deutschmann, B., 27 Feb. 2019. 1 S.

A temperature analysis for NFC-powered smart lab-on-chip devices

Kollegger, C., Steffan, C., Greiner, P., Rabl, C., Lugitsch, D., Holweg, G. & Deutschmann, B., 22 Jan. 2019, *2018 IEEE 61st International Midwest Symposium on Circuits and Systems, MWSCAS 2018*. IEEE, Band 2018-August. S. 1058-1061 4 S. 8623976

BCI-Tests - Durchführung und Herausforderung

Winkler, G. & Deutschmann, B., 2019, *17. EMV-Fachtagung*. Winkler, G. (Hrsg.). Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, S. 127 - 139 (OVE-Schriftenreihe; Band 98).

Erratum to: Design and theoretical comparison of input ESD devices in 180 nm CMOS with focus on low capacitance (e & i Elektrotechnik und Informationstechnik, (2018), 135, 1, (69-75), 10.1007/s00502-017-0569-0)

Michalowska-Forsyth, A., Schrey, P. & Deutschmann, B., 2019, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik*. 136, 2, S. 224

System-Level Assessment of Dynamic Effects in GaN-based Power Converters

Minetto, A., Deutschmann, B., Haberlen, O. & Curatola, G., 2019, *PRIME 2019 - 15th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics, Proceedings*. IEEE, S. 281-284 4 S. 8787795

Investigation of Spice Models for Overvoltage Protection Devices with Respect to Fast Transients

Bauer, S., Renhart, W., Biro, O., Turk, C., Maier, C., Winkler, G. & Deutschmann, B., 17 Okt. 2018, *2018 IEEE Symposium on Electromagnetic Compatibility, Signal Integrity and Power Integrity, EMC, SI and PI 2018*. IEEE, 8495349

Introduction to Robust Automotive IC Design and Electromagnetic Compatibility of ICs

Deutschmann, B. & Winkler, G., 3 Sept. 2018, *Tutorial Automotive Design: 44th European Solid-State Circuits Conference*. Dresden, S. 1-42

Investigation of Spice Models for Overvoltage Protection Devices with Respect to Fast Transients

Bauer, S., Renhart, W., Bíró, O., Türk, C., Maier, C., Winkler, G. & Deutschmann, B., 3 Aug. 2018, *2018 IEEE Symposium on Electromagnetic Compatibility Signal Integrity and Power Integrity*. IEEE Publications, S. 1-1 1 S. 8495349

Emission reduction with spread spectrum clocking for switched capacitor buck converter

Subotskaya, V., Cherniak, K., Hoermaier, K. & Deutschmann, B., 22 Juni 2018, *2018 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and 2018 IEEE Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility, EMC/APEMC 2018*. IEEE, S. 297-302 6 S.

The shielding effect of a multi-cable harness as function of IC output termination impedance

Hackl, H., Auinger, B., Deutschmann, B. & Gheonjian, A., 22 Juni 2018, *2018 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and 2018 IEEE Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility, EMC/APEMC 2018*. IEEE, S. 707-712 6 S.

Time domain FEM computational approach for calibration of surface scan method

Bauer, S., Biro, O., Koczka, G., Gleinser, A., Winkler, G. & Deutschmann, B., 22 Juni 2018, *2018 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and 2018 IEEE Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility, EMC/APEMC 2018*. IEEE, S. 866-871 6 S.

Characterization of Passive Components based on a Power Converter Filter Circuit

Odreitz, K., Auinger, B., Fuchs, M., Winkler, G. & Deutschmann, B., 12 Juni 2018.

Employing Mixed-Mode S-parameters for Characterizing Mode Conversions in Power Converter PCBs

Auinger, B., Odreitz, K., Fuchs, M., Winkler, G. & Deutschmann, B., 12 Juni 2018.

Improving SiC Power MOSFET Simulation Models for EMC Applications

Fuchs, M., Sygulla, C., Auinger, B., Eberl, J., Javoric, H., Winkler, G. & Deutschmann, B., 12 Juni 2018.

Improving SiC Power MOSFET Simulation Models for EMC Applications

Fuchs, M., Sygulla, C., Auinger, B., Eberl, J., Winkler, G. & Deutschmann, B., 12 Juni 2018, *16. EMV Fachtagung: störungsfreie Elektronik und Geräte.* (OVE-Schriftenreihe ; Band 92).

Using Gate Signal Shaping to Lower Conducted Emissions of a Power Converter

Auinger, B., Pichler, L., Fuchs, M., Winkler, G. & Deutschmann, B., 12 Juni 2018.

Wie „smart“ ist Smart Power Leistungselektronik unter Störbeeinflussung

Deutschmann, B., Winkler, G. & Kastner, P., 12 Juni 2018, *16. EMV-Fachtagung.* Lamedschwandner, K. (Hrsg.). Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 92. S. 177-188

Herausforderung EMV in der Leistungselektronik

Fuchs, M., Auinger, B., Pichler, L., Herdin, M. & Deutschmann, B., Mai 2018, in: *Elektronik. Sonderh. Power*, S. 12-17

Großes Interesse an winzigen Bauelementen

Deutschmann, B., 18 Feb. 2018, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik.* 1, S. 12-14

Entwicklung von Simulationsmethoden für die Bestimmung der Schirmdämpfung von realen Gerätegehäusen

Cecil, S., Lamedschwandner, K., Auinger, B., Deutschmann, B., Winkler, G., Ritzberger, G. & Boxleitner, P., 1 Jan. 2018, *EMV 2018 - Internationale Fachmesse und Kongress für Elektromagnetische Verträglichkeit.* Mesago Messe Frankfurt GmbH, Band 2018-February. S. 199-206 8 S.

Design and theoretical comparison of input ESD devices in 180 nm CMOS with focus on low capacitance

Michalowska-Forsyth, A. M., Schrey, P. & Deutschmann, B., 2018, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik.* 135, S. 69–75

Development of simulation methods for the determination of the shielding effectiveness of real instrument housings

Cecil, S., Lamedschwandner, K., Auinger, B., Deutschmann, B., Winkler, G., Ritzberger, G. & Boxleitner, P., 2018, *EMV 2018 - Internationale Fachmesse und Kongress für Elektromagnetische Verträglichkeit.*

Fault state behavior of smart power devices during electromagnetic interference

Deutschmann, B., Kastner, P. & Winkler, G., 2018, *2018 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility and 2018 IEEE Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility, EMC/APEMC 2018.* IEEE, S. 44-49 6 S.

Impact of electromagnetic interference on the functional safety of smart power devices for automotive applications

Deutschmann, B., Winkler, G. & Kastner, P., 2018, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik.* 135, 4-5, S. 352-359 8 S.

Innovativer HVDC-DC-Wandler für Hochspannungs-Gleichstrom-Netze – Grundsätzliche Überlegungen zu Topologie, Regelung und elektromagnetischer Verträglichkeit

Renner, H., Schichler, U., Krischan, K., Deutschmann, B., Auinger, B., Horn, M., Reichhartinger, M. & Vollmaier, F., 2018, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik.* 135, 8, S. 497-506 10 S.

Intelligent NFC potassium measurement strip with hemolysis check in capillary blood

Kollegger, C., Greiner, P., Siegl, I., Steffan, C., Wiessflecker, M., Pekec, B., Hajnsek, M., Sinner, F., Holweg, G. & Deutschmann, B., 2018, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik.* 135, S. 83-88 6 S.

Mikroelektronik aus Österreich – Grundlage für Österreichs Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit

Deutschmann, B., 2018, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik*. 135, 1, S. 1-2 2 S.

On the Robustness of CMOS-Chopped Operational Amplifiers to Conducted Electromagnetic Interferences

Lavarda, A., Petrucci, L., Radez, N. & Deutschmann, B., 2018, in: *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*. 60, 2, S. 478-486

Optimized gate driver for high-frequency buck converter

Subotskaya, V., Mihal, V., Tulupov, M. & Deutschmann, B., 2018, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik*. 135, S. 40-47

Computing the electromagnetic emission spectrum of pulses by convolution in frequency domain

Hackl, H. & Deutschmann, B., 2 Nov. 2017, *2017 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE 2017, EMC Europe 2017*. IEEE, 8094699

Elimination of electromagnetic interference in communication channels by using spread spectrum techniques

Auinger, B., Deutschmann, B. & Winkler, G., 2 Nov. 2017, *2017 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE 2017, EMC Europe 2017*. IEEE, 8094666

A system-on-chip NFC bicycle tire pressure measurement system

Kollegger, C., Greiner, P., Steffan, C., Froehlich, H., Kautzsch, T., Holweg, G. & Deutschmann, B., 27 Sept. 2017, *2017 IEEE 60th International Midwest Symposium on Circuits and Systems, MWSCAS 2017*. IEEE, Band 2017-August. S. 60-63 4 S. 8052860

Autonomous maximum power point tracking algorithm for ultra-low power energy harvesting

Steffan, C., Greiner, P., Kollegger, C., Siegl, I., Holweg, G. & Deutschmann, B., 27 Sept. 2017, *2017 IEEE 60th International Midwest Symposium on Circuits and Systems, MWSCAS 2017*. IEEE, Band 2017-August. S. 1372-1375 4 S. 8053187

Adaptive current source driver for high-frequency boost converter

Subotskaya, V., Bodano, E. & Deutschmann, B., 31 Juli 2017, *Proceedings of the 2017 11th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits, EMCCompo 2017*. IEEE, S. 85-90 6 S. 7998087

Enhancement of the DPI method for IC immunity characterization

Lavarda, A., Deutschmann, B. & Haerle, D., 6 Juli 2017, *Proc. of International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2017)*. S. 178-183

Spread spectrum parameter optimization to suppress certain frequency spectral components

Deutschmann, B., Auinger, B. & Winkler, G., 6 Juli 2017, *Proc. of International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2017)*. S. 39-44

Adaptive current source driver for high-frequency boost converter to reduce EMI generation

Subotskaya, V. & Deutschmann, B., 14 Juni 2017, *Proc. 13th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (PRIME) 2017*. S. 333-336

Pre-estimating the Electromagnetic Interference (EMI) of Electronic Systems

Auinger, B., Deutschmann, B., Winkler, G., Cecil, S. & Lamedschwandner, K., 27 Apr. 2017, S. 15. 1 S.

Störemission von Leistungselektronik

Deutschmann, B., Winkler, G. & Auinger, B., 27 Apr. 2017, *15. EMV Fachtagung*. Winkler, G. (Hrsg.). 1. Aufl. Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 87. S. 222 229 S. (OVE-Schriftenreihe; Band 87).

Electromagnetic Emission Scanning at the Surface of ICs

Deutschmann, B., Gleinser, A. & Reitter, P., 26 Apr. 2017, 15. EMV-Fachtagung: OVE Schriftenreihe Nr. 87. Winkler, G. (Hrsg.). Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 87. S. 16 1 S.

ESD Robustheit und Wunsch-Bell Charakteristik

Schrey, P., Deutschmann, B. & Winkler, G., 26 Apr. 2017, 15. EMV-Fachtagung: OVE Schriftenreihe Nr. 87. Winkler, G. (Hrsg.). Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 87. S. 21

GridConv: HVDC-DC Converter for High Voltage Direct Current Transmission Systems – Background and Design

Krischan, K., Schichler, U., Deutschmann, B., Reichhartinger, M., Auinger, B., Vollmaier, F., Horn, M. & Renner, H., 26 Apr. 2017, 15. EMV-Fachtagung / Leistungselektronikschau: OVE Schriftenreihe Nr. 87. Winkler, G. (Hrsg.). Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 87. S. 41 1 S.

GridConv: HVDC-DC Converter for High Voltage Direct Current Transmission Systems – Background and Design

Krischan, K., Schichler, U., Deutschmann, B., Reichhartinger, M., Auinger, B., Vollmaier, F., Horn, M. & Renner, H., 26 Apr. 2017. 1 S.

GridConv: HVDC-DC Converter for High Voltage Direct Current Transmission Systems – The Electronic System

Deutschmann, B., Auinger, B., Vollmaier, F., Krischan, K., Schichler, U., Horn, M., Reichhartinger, M. & Renner, H., 26 Apr. 2017, 15. EMV-Fachtagung / Leistungselektronikschau: OVE Schriftenreihe Nr. 87. Winkler, G. (Hrsg.). Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 87. S. 42 1 S.

GridConv: HVDC-DC Converter for High Voltage Direct Current Transmission Systems – The Electronic System

Deutschmann, B., Auinger, B., Vollmaier, F., Krischan, K., Schichler, U., Horn, M., Reichhartinger, M. & Renner, H., 26 Apr. 2017, S. 42. 1 S.

Robustheitsuntersuchung von Leistungselektronik

Schrey, P., Deutschmann, B. & Winkler, G., 26 Apr. 2017, 15. EMV-Fachtagung: OVE Schriftenreihe Nr. 87. Winkler, G. (Hrsg.). Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 87. S. 47

Design of a NFC Bicycle Tire Pressure Measurement System

Kollegger, C., Holweg, G., Fröhlich, H., Kautzsch, T. & Deutschmann, B., 27 Okt. 2016.

Solar Harvestign with On-Chip PV Cells and Maximum Power Point Tracking

Steffan, C., Holweg, G. & Deutschmann, B., 27 Okt. 2016.

An EMI receiver model to minimize simulation time of long data transmissions

Hackl, H. & Deutschmann, B., 19 Okt. 2016, *Proceedings - 2016 24th Austrian Workshop on Microelectronics, Austrochip 2016*. S. 57-62 6 S.

EMI Rejection of Operational Amplifiers

Winkler, G. & Deutschmann, B., 12 Apr. 2016, 14. EMV-Fachtagung. Lamedschwandner, K. (Hrsg.). Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 82. S. 62-81

Obstacles in Predicting ESD Robustness according to ISO10605 of Electronic Systems with Automotive Examples

Ammer, M. & Deutschmann, B., 9 März 2016, *Proceedings of SSI 2016: International Conference and Exhibition on Integration Issues of Miniaturized Systems*. Mesago GmbH, S. 61 - 70

Placement of Components for DC-DC-Converters

Deutschmann, B. & Winkler, G., 19 Feb. 2016.

Placement of Components for DC-DC-Converters (Live Demo)

Deutschmann, B. & Winkler, G., 18 Feb. 2016.

Elektromagnetische Verträglichkeit und Robustheit elektronischer Systeme als Herausforderung des Technologiezeitalters
Deutschmann, B., 2016, in: Elektrotechnik und Informationstechnik. 133, 1, S. 1-2

Highlighting the distribution path of transient disturbances by near field scanning techniques

Deutschmann, B., Schindlbacher, S. & Winkler, G., 2016, in: Elektrotechnik und Informationstechnik. 133, 1, S. 18-24

Intelligent plaster for accurate body temperature monitoring and investigations regarding EMI using near-field magnetic scan

Kollegger, C., Steffan, C., Greiner, P., Wiessflecker, M., Holweg, G. & Deutschmann, B., 2016, in: Elektrotechnik und Informationstechnik. 133, 1, S. 25-31

Von der Blitzentladung bis zu ESD-Testverfahren: Beanspruchungen von Geräten und integrierten Schaltungen sowie normative Anforderungen

Deutschmann, B., Winkler, G. & Pack, S., 2016, in: Elektrotechnik und Informationstechnik. 133, 1, S. 3-10

NFC in medizinischen Anwendungen

Kollegger, C., Deutschmann, B., Winkler, G. & Steffan, C., 19 Nov. 2015.

Characterization of the immunity of integrated circuits (ICs) at wafer level

Lavarda, A., Amschl, D., Bauer, S. & Deutschmann, B., 13 Nov. 2015, *2015 10th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo)*. IEEE Publications, S. 196-201 6 S. 7358356

EMI improved chopped operational amplifier

Lavarda, A. & Deutschmann, B., 13 Nov. 2015, *2015 10th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo)*. IEEE Publications, S. 72-76 5 S. 7358333

Emission reduction in Class D audio amplifiers by optimizing spread spectrum modulation

Deutschmann, B., Winkler, G. & Karaca, T. D., Nov. 2015, *2015 10th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo)*. IEEE, 6 S.

Messbeispiele zu den wichtigsten EMV-Messverfahren

Deutschmann, B. & Winkler, G., 29 Sept. 2015.

Elektromagnetische Verträglichkeit auf Leiterplatten- und IC-Ebene

Deutschmann, B. & Winkler, G., 28 Sept. 2015.

EMC-aware Component Placement

Deutschmann, B. & Winkler, G., 24 Sept. 2015.

Platzierung von Komponenten im DCDC Wandler

Deutschmann, B. & Winkler, G., 24 Sept. 2015.

Introduction to EMC at the IC level

Deutschmann, B. & Winkler, G., 18 Sept. 2015.

IC Shielding with Soft Magnetics

Deutschmann, B. & Winkler, G., 16 Aug. 2015.

EMV-Schnuppertraining

Deutschmann, B. & Winkler, G., 29 Apr. 2015.

Richtige Auswahl und Anwendung von Kondensatoren

Winkler, G. & Deutschmann, B., 16 Apr. 2015.

Autonomous Sense and Identification Grain - A Sensor Interface Applicable for Biomedical Purposes

Kollegger, C., Holweg, G. & Deutschmann, B., 2015.

Electromagnetic Evaluation of Class-D Switching Schemes

Karaca, T. D. & Deutschmann, B., 2015, *2015 11th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (PRIME)*. IEEE, S. 113-116

EMI-Receiver Simulation Model with Quasi-Peak Detector

Karaca, T. D., Deutschmann, B. & Winkler, G., 2015, *2015 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC)*. IEEE, S. 891-896

Energy harvesting with on-chip solar cells and integrated DC/DC converter

Steffan, C., Deutschmann, B., Greiner, P., Kollegger, C. & Holweg, G., 2015, *ESSDERC 2015 - 45th European Solid State Device Research Conference*. IEEE, S. 142-145

Energy Harvesting with on-chip Solar Cells embodiment and performance of solar cells in the 0.13 μm process

Steffan, C., Holweg, G. & Deutschmann, B., 2015.

Prediction of the robustness of integrated circuits against EFT/BURST

Bauer, S. M., Deutschmann, B. & Winkler, G., 2015, *2015 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC)*. IEEE, S. 45-49

Richtige Auswahl und Anwendung von Kondensatoren

Deutschmann, B. & Winkler, G., 2015, *13. EMV-Fachtagung*. 1010 Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 79. S. 189-200 (OVE Schriftenreihe).

Simulation of radiated emission during the design phase based on scattering parameter measurement

Hackl, H., Winkler, G. & Deutschmann, B., 2015, *EMC Compo 2015 - 2015 10th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits*. IEEE, S. 228-231 4 S. 7358362

Design-Guidelines zur EMV-gerechten PCB-Entwicklung

Deutschmann, B. & Winkler, G., 2 Okt. 2014.

EMV-gerechtes Printplattendesign - Störemission

Deutschmann, B. & Winkler, G., 25 Sept. 2014.

EMV-gerechtes Printplattendesign - Störfestigkeit

Winkler, G. & Deutschmann, B., 25 Sept. 2014.

Reducing the Electromagnetic Emission of DC/DC Converters

Winkler, G. & Deutschmann, B., 4 Apr. 2014.

Abhängigkeit der Pulsfestigkeitsergebnisse von Kfz-Komponenten von den verwendeten Testpulsgeneratoren

Deutschmann, B., Klotz, F. & Wahl, A., 2014, *Elektromagnetische Verträglichkeit in der KFZ-Technik, GMM-Fachtagung 2014*. Berlin: VDE Verlag GmbH, S. 707-714

Impact of Spread Spectrum EMI-Reduction on Audio Performance of Filterless Class-D Amplifiers

Karaca, T. D., Auer, M., Winkler, G. & Deutschmann, B., 2014, *22nd Austrian Workshop on Microelectronics (Austrochip)*. IEEE, S. 47-52

Reducing the Electromagnetic Emission of DC/DC Converters

Deutschmann, B. & Winkler, G., 2014, 12. *EMV-Fachtagung*. 1010 Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 75. S. 261-274 (OVE Schriftenreihe).

EMV gerechtes Leiterplattendesign aus der Sicht von Geräteentwicklern

Deutschmann, B. & Winkler, G., 2013, 11. *EMV-Fachtagung*. 1010 Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 70. S. 149-165 (OVE Schriftenreihe).

ISO Kfz-Pulsgeneratoren - Verifikationsergebnisse und Erweiterung des Standards

Klotz, F., Deutschmann, B., Wahl, A. & Oberjatzas, G., 2013, *Elektromagnetische Verträglichkeit in der KFZ-Technik, GMM-Fachtagung 2013*. Berlin ; Offenbach: VDE Verlag GmbH, S. 63-68

Spread Spectrum Clocking for Emission Reduction of Charge Pump Applications

Deutschmann, B., 2013, 2013 9th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo). ., S. 123-128

Impulsförmige Störgrößen: Auswahl und Bestimmung der Zerstörgrenze von Schutzelementen

Deutschmann, B. & Winkler, G., 2012, 10. *EMV-Fachtagung*. 1010 Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 62. S. 185-200 (OVE Schriftenreihe).

Neue Pulsanforderungen und deren Auswirkung auf die Kfz-Elektronik

Deutschmann, B. & Klotz, F., 2012, *Elektromagnetische Verträglichkeit, EMV 2012: Internationale Fachmesse und Kongress für Elektromagnetische Verträglichkeit*. Berlin: VDE Verlag GmbH, S. 169-174

Radiated Immunity Testing of Integrated Circuits in Reverberation Chambers

Heinrich, R., Bechly, R. & Deutschmann, B., 2012, *International Symposium on Electromagnetic Compatibility*. Piscataway, NY: IEEE, S. 1-4

Correlation between systemlevel robustness and TLP results of ESD devices

Deutschmann, B., Magrini, F., Cao, Y. & Mayerhofer, M., 2011, *International Electrostatic Discharge Workshop*. ., S. ---

Edge Shaping to Reduce the Electromagnetic Emissions

Deutschmann, B., Illing, R. & Auer, B., 2011, *EMC Europe 2011 York*. Piscataway, NY: IEEE, S. 742-745

Einsatz von Spread Spectrum zur "Verringerung" elektromagnetischer Störemissionen

Deutschmann, B. & Winkler, G., 2011, 9. *EMV-Fachtagung*. 1010 Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 60. S. 137-144 (OVE Schriftenreihe).

EMC Robust Design for Smart Power High Side Switches

Deutschmann, B. & Del Croce, P., 2011, *Analog circuit design*. Casier, H. (Hrsg.). Berlin [u.a.]: Springer, S. 89-104

Internal IC Protection Structures in Relation to New Automotive Transient Requirements

Deutschmann, B., Magrini, F. & Klotz, F., 2011, *EMC Compo 2011 proceedings*. Piscataway, NJ: IEEE, S. 47-52

Störfestigkeit gegen transiente Störgrößen

Winkler, G. & Deutschmann, B., 18 März 2010.

Flankensteilheitsdefinition kontra EMV Messung

Deutschmann, B. & Klotz, F., 2010, *Elektromagnetische Verträglichkeit*. Berlin [u.a.]: VDE Verlag GmbH, S. 519-526

Robustness of ESD Protection Structures against Automotive Transient Disturbances

Deutschmann, B., Magrini, F. & Cao, Y., 2010, *Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility*. Piscataway, NY: IEEE, S. 1039-1042

EMV-gerechtes Filterdesign

Winkler, G. & Deutschmann, B., 23 Apr. 2009.

Electromagnetic immunity design of smart power high side switches

Deutschmann, B. & Del Croce, P., 2009, *International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits*. . , S. ---

Simulation und Messung der Störemission von Schaltungen mit periodischen Störquellen

Winkler, G. & Deutschmann, B., 17 Apr. 2008.

Analysis of conducted emissions in CAN bus systems with VHDL-AMS

Gürsoy, M., Jahn, S., Deutschmann, B. & Pelz, G., 2008, *International Symposium on Electromagnetic Compatibility*. Piscataway, NJ: IEEE, S. 147-152

Application of GTEM Cells for IC EMC Testing

Heinrich, R., Müllerwiebus, V., Lange, A., Deutschmann, B., Karsten, U. & Klotz, F., 2008, *Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility*. ., S. 267-270

EMV elektronischer Unterbaugruppen und integrierter Schaltkreise im Kraftfahrzeug

Lamedschwandner, K., Preineder, H., Winkler, G., Deutschmann, B. & Ostermann, T., 2008, in: HF-Report. 123, 1/2, S. 40-44

Error of Emission Measurement of ICs due to Imperfect Termination of TEM Cell

Müllerwiebus, V., Deutschmann, B. & Klotz, F., 2008, *International Symposium on Electromagnetic Compatibility*. Piscataway, NJ: IEEE, S. 263-267

Methodology to Predict EME Effects in CAN Bus Systems Using VHDL-AMS

Gürsoy, M., Jahn, S., Deutschmann, B. & Pelz, G., 2008, in: IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 50, 4, S. 993-1002

Tipps zum EMV-gerechten Schaltungs- und Leiterplattenentwurf

Deutschmann, B. & Winkler, G., 12 Juni 2007.

Estimation of the Conducted Emissions of High Side Switches by Using Circuit Simulations

Deutschmann, B., 2007, *International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits*. ., S. 19-24

Störfestigkeit integrierter Schaltungen gegenüber hochfrequenten leitungsgeführten Störgrößen

Winkler, G. & Deutschmann, B., 4 Mai 2006.

Die ESD Prüfung von integrierten Schaltungen als Teilbereich der EMV Anforderungen an elektronische Komponenten im KFZ

Deutschmann, B., Lamedschwandner, K., Winkler, G. & Ostermann, T., 2006, *Tagungsband Austrochip*. Wien: Fachhochschule Technikum Wien, S. 75-81

Electrostatic Discharge Models

Deutschmann, B., 2006, *Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits: Techniques for Low Emission and Susceptibility*. 1 Aufl. New York, NY: Springer, S. 189-200

EMV elektronischer Unterbaugruppen und integrierter Schaltkreise im Kraftfahrzeug

Lamedschwandner, K., Preineder, H., Winkler, G., Deutschmann, B. & Ostermann, T., 2006, *Elektromagnetische Verträglichkeit*. Berlin Offenbach: VDE Verlag GmbH, S. 373-380

EMV elektronischer Unterbaugruppen und integrierter Schaltkreise im Kraftfahrzeug

Lamedschwandner, K., Preineder, H., Winkler, G., Deutschmann, B. & Ostermann, T., 2006, *EMC 2006 - International Trade Fair and Conference on Electromagnetic Compatibility*.

ICs als Quelle der Störemissionen von elektronischen Geräten und Systemen?

Deutschmann, B., 2006, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik*. 123, 1/2, S. 15-21

On the Effects of Transient Electromagnetic Interference on Integrated Circuits

Deutschmann, B., Sicard, E. & Ben Dhia, S., 2006, in: *Electronic Device Failure Analysis*. 8, 4, S. 16-24

Vergleichende EMV-Untersuchungen auf Geräte- und IC-Ebene

Lamedschwandner, K., Deutschmann, B., Winkler, G. & Ostermann, T., 2006, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik*. 123, 1-2, S. 9-14

Störfestigkeit integrierter Schaltungen gegen leitungsgeführte transiente Störgrößen

Deutschmann, B. & Winkler, G., 31 März 2005.

A Comparison of Conducted Transient Disturbances and Failure Signatures for CMOS Integrated Circuits

Deutschmann, B., 2005, *International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits*. ., S. 151-156

Design Methods Implicating Electromagnetic Compatibility for Systems in Package

Loipold, G. & Deutschmann, B., 2005, *International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits*. ., S. 73-78

Digital Output Cell with Reduced Slew Rate and Smooth Signal Transition

Ostermann, T., Bacher, C. & Deutschmann, B., 2005, *International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits*. ., S. 69-72

EMC awareness for multi chip modules

Loipold, G. & Deutschmann, B., 2005, in: *Elektrotechnik und Informationstechnik*. 122, 12, S. 460-465

EMC Aware Programming of Micro Controller Based Systems

Steiner, M., Deutschmann, B. & Lamedschwandner, K., 2005, *International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits*. ., S. 63-68

IC- versus Systemlevel-EMV

Deutschmann, B. & Pitsch, H., 2005, in: *E&E-Kompodium*. 2005/06, S. 211-213

Modeling of Transient Automotive Pulses According to ISO 7637

Deutschmann, B. & Maier, D., 2005, *International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits*. ., S. 225-229

Modellierung transienter Störgrößen

Deutschmann, B. & Maier, D., 2005, in: *E&E-Kompodium*. 2005/06, S. 240-242

Near Field Measurements to Predict the Electromagnetic Emission of Integrated Circuits

Deutschmann, B., Pitsch, H. & Langer, G., 2005, *International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits*. ., S. 27-32

Störemission von integrierten Schaltungen auf Leiterplatten

Winkler, G. & Deutschmann, B., 21 Apr. 2004.

AS2522: starter kit for communications device manufacturers

Deutschmann, B., 2004, in: *Electronic Engineering & Product World*. 2004, 21, S. 125-126

Auf den richtigen Schaltzeitpunkt kommt es an (die Reduzierung von Ground Bounce und Ringing durch Skewing der Schaltzeitpunkte)

Deutschmann, B. & Winkler, G., 2004, in: *D&V-Kompodium*. 2004/05, S. 237-239

Characterization of the Radiated Electromagnetic Emission of Clock Trees

Ostermann, T., Lackner, B. & Deutschmann, B., 2004, *International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits*. , S. 188-193

Characterizing the Immunity of Integrated Circuits against Electrical Fast Transient Disturbances

Deutschmann, B., Langer, G. & Auderer, G., 2004, *International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits*. , S. 150-153

Das „Missing Link“ der EMV zwischen Geräte- und IC-Ebene

Ostermann, T., Lamedschwandner, K., Deutschmann, B. & Winkler, G., 2004, *Austrochip-Tagung 2004*. , S. 111-117

Electromagnetic Emissions: IC-Level versus System-Level

Deutschmann, B., Winkler, G., Ostermann, T. & Lamedschwandner, K., 2004, *IEEE Symposium on Electromagnetic Compatibility 2004*. , S. 169-173

Electromagnetic Immunity: System- versus Chip-Level

Deutschmann, B., Winkler, G., Ostermann, T. & Lamedschwandner, K., 2004, *EMC Europe, International Symposium on Electromagnetic Compatibility / Vol. 2*. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, S. 843-848

EMV auf Geräte-, System- und IC-Ebene - Das EMV-Verhalten von Geräten und Systemen im Vergleich zur EMV-Charakterisierung auf IC-Ebene

Ostermann, T., Winkler, G., Lamedschwandner, K. & Deutschmann, B., 2004, in: *D&V-Kompodium*. 2004/05, S. 288-291

EMV-Charakterisierung von Integrierten Sensorschaltungen

Ostermann, T. & Deutschmann, B., 2004, *Sensoren und Messsysteme 2004*. Düsseldorf: VDI, Band 1829. S. 859-862 (VDI-Berichte).

Gegenüberstellung der messtechnischen und normativen EMV-Anforderungen auf IC- und Geräteebe

Ostermann, T., Lamedschwandner, K., Deutschmann, B. & Winkler, G., 2004, *12. Internationale Fachmesse und Kongress für Elektromagnetische Verträglichkeit/EMV 2004*. Berlin Offenbach: VDE Verlag GmbH, S. 421-427

Influence of the Power Supply on the Radiated Electromagnetic Emission of Integrated Circuits

Ostermann, T., Deutschmann, B. & Bacher, C., 2004, in: *Microelectronics Journal*. 35, 6, S. 525-530

Measuring the Electromagnetic Emissions of Integrated Circuits with IEC 61967-4

Deutschmann, B., Winkler, G. & Jungreithmair, R., 2004, *Symposium record ; vol. 1*. Piscataway, NY: IEEE, S. 12-17

Neues Burst-Messverfahren - Charakterisierung der Störfestigkeit von ICs gegen Bursts

Deutschmann, B., Langer, G. & Auderer, G., 2004, in: *D&V-Kompodium*. 2004/05, S. 282-284

Starter kits reduce time to market

Deutschmann, B., 2004, in: --Fachzeitschrift nicht gefunden--. S. 96-97

The Right Pinning to Reduce the Electromagnetic Emission of Integrated Circuits

Deutschmann, B., Winkler, G., Ostermann, T. & Tanda, A., 2004, *Euro electromagnetics : book of abstracts*. Univ. Magdeburg, S. 107-107

Using Device Simulations to Optimize ESD Protection Circuits

Fankhauser, B. & Deutschmann, B., 2004, *International Symposium on Electromagnetic Compatibility*. , S. 963-968

EMV-Anforderungen an informationstechnische Einrichtungen (EN55024)

Deutschmann, B. & Winkler, G., 26 Feb. 2003.

A Measurement Example to Show the Relationship between the electromagnetic emission And The Ground bounce Voltage of an Integrated Circuit

Deutschmann, B., Ostermann, T., Bacher, C. & Jungreithmair, R., 2003, *IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems*. , S. 195-200

A Test-Chip to Characterize the Benefit of On-chip Decoupling to Reduce the Electromagnetic Emission of Integrated Circuits

Ostermann, T., Bacher, C., Schneider, D., Gut, W., Lackner, C., Koessl, R., Hagelauer, R., Deutschmann, B. & Jungreithmair, R., 2003, *International Symposium on Electromagnetic Compatibility*. , S. 44-47

Characterization of the EME of Integrated Circuits with the Help of the IEC Standard 61967

Ostermann, T. & Deutschmann, B., 2003, *European Test Workshop*. Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society, S. 132-137

Characterization of the EME of Integrated Circuits with the Help of the IEC Standard 61967

Ostermann, T. & Deutschmann, B., 2003, *Digest of papers*. , S. 269-274

Characterization of the EME of integrated circuits with the help of the IEC standard 61967 [electromagnetic emission]

Ostermann, T. & Deutschmann, B., 2003, *Proceedings of the European Test Workshop*.

CMOS Output Driver with Reduced Ground Bounce and Electromagnetic Emission

Deutschmann, B. & Ostermann, T., 2003, *ESSCIRC 2004 - 29th European Solid-State Circuits Conference* . Piscataway, NY: IEEE, S. 537-540

Darstellung der TEM-Zellen und der Surface Scan Messmethode zur Untersuchung des Einflusses von On-Chip Decoupling Kapazitäten auf die Störemission von Integrierten Schaltungen

Ostermann, T., Deutschmann, B., Schneider, D. & Jungreithmair, R., 2003, *ITG-Workshop Testmethods and Reliability of Circuits and Systems*. , S. 66-69

Direct Power Injection (DPI) to Measure the Immunity of Integrated Circuits Against Conducted Disturbances

Deutschmann, B. & Ostermann, T., 2003, *International Mixed-Signal Testing Workshop*. , S. 264-267

Effects of Skewing Output Driver Switching on the Electromagnetic Emission

Deutschmann, B., Jungreithmair, R. & Winkler, G., 2003, *IEEE Symposium on Electromagnetic Compatibility 2003*. , S. 236-241

EMV-Charakterisierung von ICs (Die neuen Normen zur Charakterisierung der EMV integrierter Schaltungen)

Deutschmann, B., Winkler, G. & Jungreithmair, R., 2003, in: *Test-Kompodium*. 2003, S. 35-37

EMV in der Kraftfahrzeugtechnik (EMV-Anforderungen an elektrische/elektronische Komponenten und integrierte Schaltungen)

Lamedschwandner, K. & Deutschmann, B., 2003, in: *EMC-Kompodium*. S. 196-199

EMV-Messungen auf IC-Ebene gemäß den Normen IEC 61967 und IEC 62132

Ostermann, T. & Deutschmann, B., 2003, *ITG Diskussionssitzung Messverfahren der EMV (FA 9.1)*. , S. 70-73

Ground Bounce and Simultaneous Switching Noise

Ostermann, T., Tanda, A. & Deutschmann, B., 2003, *Beiträge der Informationstagung Mikroelektronik 2003*. Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 33. S. 449-453 (ÖVE-Schriftenreihe).

Improvement of system robustness through EMC optimization

Deutschmann, B., 2003, *Analog Circuit Design: Fractional-N Synthesizers, Design for Robustness, Line and Bus Drivers*. Roermund, A., Steyaert, M. & Huijsing, J. H. (Hrsg.). 1 Aufl. Boston, Mass. [u.a.]: Kluwer, S. 227-242

Measures to Reduce the Electromagnetic Emission of a SoC

Ostermann, T., Deutschmann, B., Gut, W. & Bacher, C., 2003, *VLSI-SoC 2013*. Darmstadt: Technische Universität Darmstadt, S. 31-36

Messmethode zur Messung der leitungsgeführten Störemission von ICs (Die Probleme mit der 150 Ohm Methode, IEC 61967-4)

Deutschmann, B., Winkler, G. & Jungreithmair, R., 2003, in: EMC-Kompodium. 2003, S. 174-176

Neue Burst-Generatoren zur Prüfung der Störfestigkeit von integrierten Schaltkreisen

Deutschmann, B., Langer, G. & Auderer, G., 2003, *Austrochip*. Linz: Inst. für Integrierte Schaltungen, Johannes-Kepler-Univ., S. 9-12

Störemission integrierter Schaltungen im Vergleich zur Störstrahlung elektronischer Geräte

Winkler, G., Deutschmann, B., Lamedschwandner, K. & Ostermann, T., 2003, *Beiträge der Informationstagung Mikroelektronik 2003*. Wien: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Band 33. S. 221-226 (ÖVE-Schriftenreihe).

TEM-Cell and Surface Scan to Identify the Electromagnetic Emission of Integrated Circuits

Ostermann, T. & Deutschmann, B., 2003, *VLSI in the nanometer era*. New York, NY: Association of Computing Machinery, S. 76-79

Visualizing the Electromagnetic Emission at the Surface of ICs

Deutschmann, B. & Jungreithmair, R., 2003, *Symposium record ; Vol. 2*. Piscataway, NY: IEEE, S. 1125-1128

Bitte nicht stören! Störemission und Störfestigkeit von Kfzs

Deutschmann, B. & Lamedschwandner, K., 2002, in: Design & Elektronik. 3, S. 59-62

Characterization of Integrated Circuits Electromagnetic Emission with IEC 61967-4

Deutschmann, B., Winkler, G. & Jungreithmair, R., 2002, *International Symposium on Electromagnetic Compatibility*. .., S. 493-497

Characterization of the influence of different power supply styles on the electromagnetic emission of ICs by using the TEM-Cell method (IEC 61967-2)

Ostermann, T., Schneider, D., Bacher, C., Deutschmann, B., Jungreithmair, R., Gut, W., Lackner, C., Koessl, R. & Hagelauer, R., 2002, *International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits*. .., S. 57-60

EMV-Prüfungen für Kraftfahrzeuge

Lamedschwandner, K. & Deutschmann, B., 2002, in: Elektronik-Report. 11, S. 6-7

Let's get started, Starterkits erleichtern Elektronikentwicklung

Deutschmann, B. & Greimel-Rechling, B., 2002, in: Design & Elektronik. 5, S. 35-36

Measuring the Electromagnetic Emissions of Integrated Circuits with IEC 61967-4 ((The Measuring Method and its Weaknesses)

Deutschmann, B., Winkler, G. & Jungreithmair, R., 2002, *Symposium record ; vol. 1*. Piscataway, NY: IEEE, S. 407-412

Surface scan to pinpoint EMC problems

Deutschmann, B. & Jungreithmair, R., 2002, *Austrochip 2002*. Graz: Inst. für Elektronik, Techn. Univ. Graz, S. 73-77

Ungestörtes Fahrvergnügen? - EMV von Kfz-Elektronik

Deutschmann, B., 2002, *Begleittexte zum Entwicklerforum Kfz-Elektronik*. Poing: Design & Elektronik, S. 223-231

Untersuchung des Einflusses von On-Chip Decoupling Kapazitäten auf die Verringerung der Störemission von Integrierten Schaltungen

Ostermann, T., Schneider, D., Bacher, C., Deutschmann, B., Jungreithmair, R., Lackner, C., Koessl, R., Gut, W., Bauernfeind, T. & Hagelauer, R., 2002, *Kleinheubacher Tagung 2002*. ., S. ?-?

EMV-gerechte Entwicklung von integrierten Schaltkreisen

Deutschmann, B., 2001, in: EMV-ESD. 12, S. 11-13

EMV-gerechte Entwicklung von ITE-Geräten

Deutschmann, B. & Lamedschwandner, K., 2001, in: Design & verification. 12, 3, S. 22-25

EMV-gerecht Entwicklung von ITE-Geräten

Deutschmann, B. & Lamedschwandner, K., 2001, in: Telematik. 7, 1, S. 32-33

Moderate Slew Rate for Reducing the High Frequency Content

Deutschmann, B. & Winkler, G., 2001, *ISTET 01 ; Vol. 2*. Linz: ., S. 154-157

Moderate Slew Rate zur Reduzierung hochfrequenter Spektralanteile

Deutschmann, B. & Winkler, G., 2001, *Beiträge der Informationstagung ME 01*. Wien: Eigenverl. des Österr. Verb. für Elektrotechnik, Band 26. S. 333-338 (ÖVE-Schriftenreihe).

The Mythos Ground Bounce

Deutschmann, B., 2001, *Tagungsband*. Wien: Inst. für Computertechnik, TU Wien, S. 33-40

Aktivitäten

14th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits, EMC Compo 2024

Zupan, D. (Teilnehmer/-in), Czepl, N. (Teilnehmer/-in), Deutschmann, B. (Mitgliedschaft in Programmausschüssen), Pfeifer, M. (Teilnehmer/-in), Kircher, D. (Teilnehmer/-in) & Hameed, M. (Teilnehmer/-in)
7 Okt. 2024 → 9 Okt. 2024

20. EMV-Fachtagung 2023

Kircher, D. (Teilnehmer/-in), Czepl, N. (Teilnehmer/-in), Zupan, D. (Teilnehmer/-in) & Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)
27 Sept. 2023 → 28 Sept. 2023

2023 International Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility

Kircher, D. (Teilnehmer/-in), Czepl, N. (Teilnehmer/-in), Zupan, D. (Teilnehmer/-in) & Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)
4 Sept. 2023 → 8 Sept. 2023

2023 Joint Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility and International Conference on ElectroMagnetic Interference and Compatibility

Kircher, D. (Teilnehmer/-in), Czepl, N. (Teilnehmer/-in), Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in) & Hansen, J. C. (Teilnehmer/-in)
22 Mai 2023 → 25 Mai 2023

Industry Strategy Symposium Europe 2023

Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in) & Haubenwallner, C. (Teilnehmer/-in)
15 Feb. 2023 → 16 Feb. 2023

Combined Investigations of Electromagnetic Compatibility and Environmental Effects

Deutschmann, B. (Redner/in)
26 Nov. 2022

Electronica 2022

Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in), Zupan, D. (Teilnehmer/-in), Haubenwallner, C. (Teilnehmer/-in), Koffler, S. (Teilnehmer/-in), Czepl, N. (Teilnehmer/-in) & Kircher, D. (Teilnehmer/-in)
15 Nov. 2022 → 18 Nov. 2022

SEMICON Europa 2022

Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in), Zupan, D. (Teilnehmer/-in), Haubenwallner, C. (Teilnehmer/-in), Koffler, S. (Teilnehmer/-in), Czepl, N. (Teilnehmer/-in) & Kircher, D. (Teilnehmer/-in)
15 Nov. 2022 → 18 Nov. 2022

Reduction of conducted emission through optimum placement and selection of decoupling capacitors

Deutschmann, B. (Redner/in) & Winkler, G. (Redner/in)
21 Sept. 2022

19. EMV-Fachtagung 2022

Zupan, D. (Organisator/-in), Winkler, G. (Organisator/-in), Deutschmann, B. (Organisator/-in), Odreitz, K. (Organisator/-in), Kircher, D. (Teilnehmer/-in), Czepl, N. (Teilnehmer/-in), Koffler, S. (Teilnehmer/-in) & Haubenwallner, C. (Teilnehmer/-in)
20 Sept. 2022 → 22 Sept. 2022

IEEE EMC PhD Student Day 2022

Odreitz, K. (Organisator/-in), Yildiz, Ö. F. (Organisator/-in), Schuster, C. (Organisator/-in), Deutschmann, B. (Organisator/-in), Pommerenke, D. J. (Organisator/-in), Czepl, N. (Teilnehmer/-in), Esmaeili, H. (Teilnehmer/-in), Fellner, G. (Teilnehmer/-in), Gholizadeh, M. (Teilnehmer/-in), Ghosalkar, S. (Teilnehmer/-in), Kircher, D. (Teilnehmer/-in), Mi, R. (Teilnehmer/-in), Petzel, L. (Teilnehmer/-in), Rammal, Y. (Teilnehmer/-in), Schierholz, M. (Teilnehmer/-in), Wulff, M. (Teilnehmer/-in), Zhang, M. (Teilnehmer/-in) & Zupan, D. (Teilnehmer/-in)
20 Sept. 2022 → 21 Sept. 2022

2022 International Symposium on Electromagnetic Compatibility

Kircher, D. (Teilnehmer/-in), Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in), Zupan, D. (Teilnehmer/-in), Czepl, N. (Teilnehmer/-in), Fellner, G. (Teilnehmer/-in), Petzel, L. (Teilnehmer/-in) & Pommerenke, D. J. (Teilnehmer/-in)
5 Sept. 2022 → 8 Sept. 2022

Spread Spectrum Clocking (SSC) to Overcome EMI Issues

Deutschmann, B. (Redner/in)
5 Sept. 2022

Functional Safety Risks of Smart Power Devices due to EMI

Deutschmann, B. (Redner/in) & Kircher, D. (Redner/in)
13 Juli 2022

EMV 2022 - Internationale Fachmesse und Kongress für Elektromagnetische Verträglichkeit

Kircher, D. (Teilnehmer/-in) & Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)
12 Juli 2022 → 14 Juli 2022

17th International Conference on PhD Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)
12 Juni 2022 → 15 Juni 2022

Electromagnetic Emissions in Combination with TID Stress – Physical Background, Test Setup and First Results

Michalowska-Forsyth, A. M. (Redner/in), Czepl, N. (Redner/in) & Deutschmann, B. (Redner/in)

26 Apr. 2022

Electromagnetic Compatibility Essentials

Odreitz, K. (Beitragende/-r), Deutschmann, B. (Beitragende/-r) & Pommerenke, D. J. (Beitragende/-r)

22 März 2022

13th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits

Zupan, D. (Teilnehmer/-in), Czepl, N. (Teilnehmer/-in), Kircher, D. (Teilnehmer/-in) & Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)

9 März 2022 → 11 März 2022

Improving integrated circuit reliability by combining tests to ionizing radiation and electromagnetic compatibility

Vargas, F. (Redner/in), Deutschmann, B. (Redner/in), Ben Dhia, S. (Redner/in), Czepl, N. (Redner/in) & Michalowska-Forsyth, A. M. (Redner/in)

3 März 2022

13th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

1 Jan. 2022 → 31 Dez. 2022

2022 International Symposium on Electromagnetic Compatibility (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

1 Jan. 2022 → 31 Dez. 2022

Organisation des VW/DA Preises der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Baunach, M. C. (Redner/-in), Saukh, O. (Redner/-in), Pommerenke, D. J. (Redner/-in) & Deutschmann, B. (Redner/-in)

2022

SEMICON Europa 2021

Zupan, D. (Teilnehmer/-in), Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in), Kircher, D. (Teilnehmer/-in), Czepl, N. (Teilnehmer/-in) & Koffler, S. (Teilnehmer/-in)

16 Nov. 2021 → 19 Nov. 2021

Elektrostatistische Entladungen und Elektronik

Deutschmann, B. (Redner/in), Winkler, G. (Redner/in) & Pommerenke, D. J. (Redner/in)

21 Okt. 2021

2021 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility

Zupan, D. (Teilnehmer/-in), Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in), Czepl, N. (Teilnehmer/-in) & Michalowska-Forsyth, A. M. (Teilnehmer/-in)

27 Sept. 2021 → 30 Sept. 2021

2021 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

27 Sept. 2021 → 30 Sept. 2021

2021 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

27 Sept. 2021 → 30 Sept. 2021

Improving Integrated Circuit Reliability by Combining Tests to Ionizing Radiation and Electromagnetic Compatibility

Deutschmann, B. (Redner/in), Michalowska-Forsyth, A. M. (Redner/in), Czepl, N. (Redner/in) & Vargas, F. (Redner/in)

27 Sept. 2021

2021 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Vorsitzende/r)

21 Sept. 2021 → 30 Sept. 2021

2021 Joint IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility Signal and Power Integrity, and EMC Europe (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Vorsitzende/r)

21 Juli 2021 → 21 Aug. 2021

2021 International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design, and 16th Conference on PhD Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

19 Juli 2021 → 22 Juli 2021

2021 International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design, and 16th Conference on PhD Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

19 Juli 2021 → 22 Juli 2021

2021 International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design, and 16th Conference on PhD Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

19 Juli 2021 → 22 Juli 2021

13th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

1 Jan. 2021 → 31 Dez. 2021

Panel discussion - METIS4Skills

Deutschmann, B. (Redner/in)

18 Nov. 2020

System Efficient ESD Design for Robust Electronic Systems

Deutschmann, B. (Redner/in) & Pommerenke, D. J. (Redner/in)

27 Okt. 2020

28th Austrian Workshop on Microelectronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

20 Okt. 2020

28th Austrian Workshop on Microelectronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Vorsitzende/r)

7 Okt. 2020

Shielding Effectiveness of Soft Ferrite Materials

Deutschmann, B. (Redner/in), Winkler, G. (Redner/in), Khan, J. S. (Beitragende/r) & Victoria, J. (Beitragende/r)

30 Sept. 2020

Einführung in das EMV-gerechte PCB- und Gerätedesign: Emissions- & Störfestigkeitsprobleme verstehen und beseitigen

Deutschmann, B. (Redner/in) & Winkler, G. (Redner/in)

29 Sept. 2020

Microelectronic Systems Symposium 2020 (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

27 Mai 2020 → 28 Mai 2020

Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility (APEMC) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

19 Mai 2020 → 22 Mai 2020

Choosing the Right Decoupling Capacitor

Deutschmann, B. (Redner/in) & Winkler, G. (Redner/in)

13 März 2020

PCB-Design Guidelines to Reduce the Electromagnetic Emission

Deutschmann, B. (Redner/in) & Winkler, G. (Redner/in)

13 März 2020

27th Austrian Workshop on Microelectronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

24 Okt. 2019

Comparison of Harmonic Suppression Techniques

Deutschmann, B. (Redner/in)

22 Okt. 2019

EMV-gerechtes Schaltungs- und Leiterplattendesign

Deutschmann, B. (Redner/in) & Winkler, G. (Redner/in)

16 Okt. 2019

Ionizing Radiation and Electromagnetic Interference on Integrated Circuits: from the need of combined tests to current solutions

Deutschmann, B. (Redner/in)

6 Sept. 2019

Influence of impedance mismatch of bended or pinched cables on signal integrity

Bauer, S. M. (Redner/in), Türk, C. (Beitragende/r), Renhart, W. (Beitragende/r), Biro, O. (Beitragende/r), Maier, C. (Beitragende/r), Winkler, G. (Beitragende/r) & Deutschmann, B. (Beitragende/r)

24 Juli 2019

Band Specific Suppression of Harmonics and its Effects on Power Efficiency

Deutschmann, B. (Redner/in)

17 Juli 2019

15th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

15 Juli 2019 → 18 Juli 2019

15th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

15 Juli 2019 → 18 Juli 2019

15th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

15 Juli 2019 → 18 Juli 2019

15th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

15 Juli 2019 → 18 Juli 2019

How smart are smart power products under EMI?

Deutschmann, B. (Redner/in)

23 Mai 2019

4. Sitzung des Programmbeirats der Silicon Austria Labs (SAL) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

14 Mai 2019 → 15 Mai 2019

5. Sitzung des Programmbeirats der Silicon Austria Labs (SAL) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Vorsitzende/r)

14 Mai 2019 → 15 Mai 2019

6. Sitzung des Programmbeirats der Silicon Austria Labs (SAL) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

14 Mai 2019 → 15 Mai 2019

BCI-Tests - Durchführung und Herausforderung

Deutschmann, B. (Redner/in) & Winkler, G. (Redner/in)

28 Feb. 2019

Debugging EMC Problems with Oscilloscopes

Fuchs, M. (Redner/in), Deutschmann, B. (Redner/in) & Herdin, M. (Redner/in)

27 Feb. 2019

15th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

1 Jan. 2019 → 31 Dez. 2019

27th Austrian Workshop on Microelectronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

1 Jan. 2019

Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) (Externe Organisation)

Deutschmann, B. (Mitglied)

1 Jan. 2019 → 31 Dez. 2019

The 12th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

1 Jan. 2019 → 31 Dez. 2019

The 12th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

1 Jan. 2019 → 31 Dez. 2019

Simulation of the Electromagnetic Emission of Electronic Systems

Deutschmann, B. (Organisator/-in), Winkler, G. (Organisator/-in) & Fuchs, M. (Organisator/-in)

20 Dez. 2018

Olivier Gevin

Michalowska-Forsyth, A. M. (Gastgeber/in), Deutschmann, B. (Gastgeber/in) & Bezhenova, V. (Gastgeber/in)

10 Dez. 2018

Radiation Hardness Day

Michalowska-Forsyth, A. M. (Organisator/-in), Deutschmann, B. (Organisator/-in), Bezhenova, V. (Organisator/-in), Vincenzi, T. (Teilnehmer/-in) & Vorderderfler, M. (Teilnehmer/-in)
10 Dez. 2018

EMV-gerechtes Schaltungs- und Leiterplattendesign

Deutschmann, B. (Redner/in) & Winkler, G. (Redner/in)
16 Okt. 2018

26th Austrian Workshop on Microelectronics

Söser, P. (Organisator/-in), Auer, M. (Organisator/-in), Lanz, E. (Organisator/-in), Bezhenova, V. (Organisator/-in), Michalowska-Forsyth, A. M. (Organisator/-in), Dorner, E. (Organisator/-in), Eisenkölbl, D. (Organisator/-in), Fink, S. (Organisator/-in), Reisenhofer, T. (Organisator/-in), Lilek, R. (Organisator/-in) & Deutschmann, B. (Organisator/-in)
27 Sept. 2018

3. Sitzung des Programmbeirats Silicon Austria Errichtungs GmbH (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)
24 Sept. 2018 → 25 Sept. 2018

44th European Solid-State Circuits Conference

Deutschmann, B. (Organisator/-in) & Wicht, B. (Organisator/-in)
3 Sept. 2018

Introduction to Robust Automotive IC Design and Electromagnetic Compatibility of ICs

Deutschmann, B. (Redner/in) & Winkler, G. (Redner/in)
3 Sept. 2018

Investigation of Spice Models for Overvoltage Protection Devices with Respect to Fast Transients

Bauer, S. M. (Redner/in), Renhart, W. (Beitragende/r), Biro, O. (Beitragende/r), Türk, C. (Beitragende/r), Maier, C. (Beitragende/r), Winkler, G. (Beitragende/r) & Deutschmann, B. (Beitragende/r)
1 Aug. 2018

13th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)
2 Juli 2018 → 5 Juli 2018

13th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)
2 Juli 2018 → 5 Juli 2018

14th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)
2 Juli 2018 → 5 Juli 2018

Wie „smart“ ist Smart Power Leistungselektronik unter Störbeeinflussung?

Deutschmann, B. (Redner/in), Winkler, G. (Redner/in) & Kastner, P. (Redner/in)
12 Juni 2018 → 13 Juni 2018

14th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)
2 Juni 2018 → 5 Juni 2018

Time domain FEM computational approach for calibration of surface scan method

Bauer, S. M. (Redner/in), Biro, O. (Beitragende/r), Koczka, G. (Beitragende/r), Gleinser, A. (Beitragende/r), Winkler, G. (Beitragende/r) & Deutschmann, B. (Beitragende/r)
16 Mai 2018

2018 JOINT IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND ASIA-PACIFIC SYMPOSIUM ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Vorsitzende/r)
14 Mai 2018 → 17 Mai 2018

2. Sitzung des Programmbeirats Silicon Austria Errichtungs GmbH (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)
25 Apr. 2018

Lange Nacht der Forschung 2018

Bezhenova, V. (Organisator/-in), Michalowska-Forsyth, A. M. (Organisator/-in), Deutschmann, B. (Organisator/-in), Fuchs, M. (Organisator/-in), Winkler, G. (Organisator/-in), Auinger, B. (Organisator/-in), Scherzer, M. (Organisator/-in), Dorner, E. (Organisator/-in), Fink, S. (Organisator/-in), Eisenkölbl, D. (Organisator/-in), Reisenhofer, T. (Organisator/-in), Juch, N. (Organisator/-in) & Söser, P. (Organisator/-in)
13 Apr. 2018

Locating EMC problems at the surface of ICs and PCBs

Deutschmann, B. (Redner/in)
13 Apr. 2018

Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits – An Introduction to EMC Test Methods

Deutschmann, B. (Redner/in)
12 März 2018 → 16 März 2018

Gridconv - Innovativer HVDC/DC Converter für HVDC-Netze

Auinger, B. (Beitragende/r), Deutschmann, B. (Beitragende/r), Schichler, U. (Beitragende/r), Krischan, K. (Beitragende/r), Horn, M. (Beitragende/r), Reichhartinger, M. (Beitragende/r) & Renner, H. (Redner/in)
14 Feb. 2018

1. Sitzung des Programmbeirats Silicon Austria Errichtungs GmbH (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)
8 Feb. 2018

Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) (Externe Organisation)

Deutschmann, B. (Mitglied)
1 Jan. 2018 → 31 Dez. 2018

Fabian Vargas

Bezhenova, V. (Gastgeber/in) & Deutschmann, B. (Gastgeber/in)
11 Dez. 2017

Introduction to Electromagnetic Compatibility

Auinger, B. (Redner/in), Deutschmann, B. (Redner/in), Winkler, G. (Redner/in) & Fuchs, M. (Redner/in)
21 Nov. 2017 → 22 Nov. 2017

25th Austrian Workshop on Microelectronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)
12 Okt. 2017

11th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)
4 Juli 2017 → 8 Juli 2017

11th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

4 Juli 2017 → 8 Juli 2017

11th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

4 Juli 2017 → 8 Juli 2017

8th Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2011) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

4 Juli 2017 → 8 Juli 2017

8th Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2011) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

4 Juli 2017 → 8 Juli 2017

2017 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility, APEMC 2017 (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

20 Juni 2017 → 23 Juni 2017

13th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

12 Juni 2017 → 15 Juni 2017

GridConv: HVDC-DC Converter for High Voltage Direct Current Transmission Systems – Background and Design

Krischan, K. (Redner/in), Auinger, B. (Redner/in), Schichler, U. (Redner/in), Deutschmann, B. (Redner/in) & Renner, H. (Redner/in)

26 Apr. 2017

GridConv: HVDC-DC Converter for High Voltage Direct Current Transmission Systems – The Electronic System

Auinger, B. (Redner/in), Vollmaier, F. (Redner/in), Deutschmann, B. (Redner/in), Krischan, K. (Redner/in) & Schichler, U. (Redner/in)

26 Apr. 2017 → 27 Apr. 2017

Störemission von Leistungselektronik

Deutschmann, B. (Beitragende/r), Winkler, G. (Beitragende/r) & Auinger, B. (Beitragende/r)

26 Apr. 2017

Leistungselektronikschau im Rahmen der 15. EMV - Fachtagung

Muetze, A. (Organisator/-in) & Deutschmann, B. (Organisator/-in)

16 Apr. 2017

Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) (Externe Organisation)

Deutschmann, B. (Mitglied)

1 Jan. 2017 → 31 Dez. 2017

Susceptibility of Precision Operational Amplifiers to EMI

Deutschmann, B. (Redner/in)

30 Nov. 2016

Erfolgreich führen und kommunizieren

Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)

24 Nov. 2016

Arbeitsrecht für wissenschaftliche Führungskräfte

Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)

15 Nov. 2016

LTSpice Seminar with Mike Engelhardt

Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)

28 Okt. 2016

24th Austrian Workshop on Microelectronics

Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)

19 Okt. 2016

12th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics

Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)

27 Juni 2016 → 30 Juni 2016

12th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

27 Juni 2016 → 30 Juni 2016

12th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

27 Juni 2016 → 30 Juni 2016

12th Conference on Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

27 Juni 2016 → 30 Juni 2016

Spread Spectrum Clocking for Emission Reduction

Deutschmann, B. (Redner/in)

15 Juni 2016

Inauguration and Radhard Symposium

Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)

7 Juni 2016 → 8 Juni 2016

Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility & Signal Integrity (APEMC)

Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)

17 Mai 2016 → 21 Mai 2016

14. EMV Fachtagung

Deutschmann, B. (Redner/in)

12 Apr. 2016

Power Supply Meets EMC-Know How

Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)

16 Feb. 2016

Expertenworkshop "Sensorik / Mikroelektronik" im Rahmen des HTS Strategieentwicklungsprozesses

Deutschmann, B. (Teilnehmer/-in)

10 Feb. 2016

Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) (Externe Organisation)

Deutschmann, B. (Mitglied)

1 Jan. 2016 → 31 Dez. 2016

Digital Control Strategies for EMI reduced switching of Smart Power Switches

Deutschmann, B. (Ausführende/r)

18 Dez. 2015

10th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits, EMC Compo 2015 (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

10 Nov. 2015 → 15 Nov. 2015

10th International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits, EMC Compo 2015 (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

10 Nov. 2015 → 13 Nov. 2015

International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

10 Nov. 2015 → 13 Nov. 2015

International Symposium on Electromagnetic Compatibility

Deutschmann, B. (Redner/in)

16 Aug. 2015 → 22 Aug. 2015

Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

25 Mai 2015 → 29 Mai 2015

Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) (Externe Organisation)

Deutschmann, B. (Mitglied)

1 Jan. 2015 → 31 Dez. 2015

22nd Austrian Workshop on Microelectronics (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

14 Okt. 2014

AMP-S Design Symposium

Deutschmann, B. (Redner/in)

14 Mai 2014

Microelectronics Systems Symposium, MESS

Deutschmann, B. (Redner/in)

9 Mai 2014 → 10 Mai 2014

Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) (Externe Organisation)

Deutschmann, B. (Mitglied)

1 Jan. 2014 → 31 Dez. 2014

9th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

15 Dez. 2013 → 18 Dez. 2013

9th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

15 Dez. 2013 → 18 Dez. 2013

Austrochip 2013, 21st Austrian Workshop on Microelectronics

Deutschmann, B. (Redner/in)

10 Okt. 2013

8th Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2011) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

6 Nov. 2011 → 9 Nov. 2011

7th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2009) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

17 Nov. 2009 → 19 Nov. 2009

7th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2009) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

17 Nov. 2009 → 18 Nov. 2009

7th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2009) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

17 Nov. 2009 → 18 Nov. 2009

7th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2009) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

17 Nov. 2009 → 19 Nov. 2009

7th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2009) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Mitglied)

17 Nov. 2009 → 19 Nov. 2009

7th International Workshop on Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMC Compo 2009) (Veranstaltung)

Deutschmann, B. (Peer reviewer)

17 Nov. 2009 → 19 Nov. 2009

Projekte

Absorbers - Elektronische Messungen mit Absorbern

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

17/04/19 → 22/05/20

ARCADE - Neue und erweiterte dynamische Pulstestkonzepte für integrierte und diskrete Leistungshalbleiter

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/05/24 → 30/04/27

Cotomics - Computertomographie IC mit hoher Strahlungsimmunität

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Michalowska-Forsyth, A. M. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/02/15 → 30/11/18

Dissertation Schneider - Bewertung der Einflussgrößen auf die Lebensdauer von resonanten MEMS-Spiegeln anhand von Strommessungen

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/09/23 → 31/08/26

Elektromagnetische Verträglichkeit elektronischer Systeme

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Winkler, G. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/01/95 → 31/12/24

Elektronische Schaltungstechnik

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/01/95 → 31/12/24

EM2APS - Verbesserte Materialien, Methoden und Anwendungen für Power Devices & Systems

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/10/14 → 30/09/17

EMV-Geräte - EMV gerechte Geräteentwicklung

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/08/24 → 31/07/25

EMV Support - Elektromagnetische Verträglichkeit Support

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

26/08/21 → 30/09/22

ESD PROMEMO - ESD Protection Structure Design & Prototyping, Measurement and Modeling

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/08/21 → 30/06/22

EU - NanoCaTe - Nano-carbons for versatile power supply modules

Kappel, R. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/10/13 → 30/09/17

FPES2020 - Zukunft der Leistungselektronik-Systeme 2020

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/05/15 → 30/04/18

Inno-EBS - Interdisziplinärer Wissenstransfer in Electronic Based Systems (EBS) zur Stärkung der Akteure der Wertschöpfungskette

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Jandl, M. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Kreuzer, E. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/02/20 → 31/07/23

METIS - Mikroelektronik-Ausbildung, Industrie und Kompetenzen

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/01/20 → 31/12/23

PREMI - Vorabschätzung der elektromagnetischen Störungen elektronischer Systeme

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/01/22 → 30/06/24

R-MULTICHARM - Multidisziplinäre Charakterisierung & Modellierung für innovative Prozess- & Produktintegration

Radl, S. (Teilnehmer (Co-Investigator)), Rosenauer, P. (Teilnehmer (Co-Investigator)) & Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/03/21 → 29/02/24

Robust SiC - Robustes Mehrkanal-Anwendungsstresskonzept für neue Hochleistungs-Halbleitertechnologien

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))

1/03/19 → 28/02/22

Smart Power ASICs - Evaluierung und Bewertung von Fehlfunktionen von betriebenen Smart Power ASICs während ESD-Gunshot-Test. Erarbeitung von Messverfahren, Laboranalysen und Designmaßnahmen für robustes Design.

Deutschmann, B. (Teilnehmer (Co-Investigator))
1/02/25 → 31/01/28